

证券代码：002618

证券简称：丹邦科技

公告编号：2020-047

## 深圳丹邦科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要

### 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

是否以公积金转增股本

是  否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 547920000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.03 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

### 二、公司基本情况

#### 1、公司简介

股票简称	丹邦科技	股票代码	002618
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	莫珊洁		
办公地址	广东省深圳市南山区高新园朗山一路丹邦科技大楼		
电话	0755-26511518、0755-26981518		
电子信箱	msj@danbang.com		

#### 2、报告期主要业务或产品简介

公司目前主营业务所属行业为柔性印制电路板及材料制造业，包括FPC、COF柔性封装基板、COF产品及关键配套材料聚酰亚胺薄膜（PI膜）的研发、生产与销售。

（一）主要业务

1、FPC、COF柔性封装基板及COF产品

FPC（Flexible Printed Circuit Board）即柔性印制电路板，是连接电子零件用的基板和电子产品信号传输的媒介。COF

柔性封装基板作为FPC的高端分支产品，指还未装联上芯片、元器件的封装型柔性基板，在芯片封装过程中，起到承载芯片、电路连通、绝缘支撑的作用，特别是对芯片起到物理保护、提高信号传输速率、信号保真、阻抗匹配、应力缓和、散热防潮的作用。COF产品（Chip on flexible printed circuit）是用COF柔性封装基板作载体，将半导体芯片直接封装在柔性基板上形成的芯片封装产品。公司致力于在微电子领域为客户提供全面的柔性互连解决方案及基于柔性基板技术的芯片封装方案。公司FPC、COF柔性封装基板及COF产品具有配线密度高、厚度薄、重量轻、配线空间限制少、可折叠、灵活度高等优点，适用于空间狭小、可移动、可折叠的各类高精尖智能终端产品，在消费电子、医疗器械、特种计算机、智能显示、高端装备产业等微电子领域都得到广泛应用。

## 2、聚酰亚胺薄膜（PI膜）

聚酰亚胺薄膜（PI膜）是一种新型的耐高温有机聚合物薄膜，按照用途分为一般绝缘和耐热为主要性能指标的电工级和赋有高挠性、低膨胀系数等性能的电子级。用于电子信息产品中的电子级PI薄膜作为特种工程材料具有其他高分子材料所无法比拟的高耐热/氧性能、优良的机械性能、电性能及化学稳定性，被称为“黄金薄膜”。微电子级PI膜最大的应用市场是作为柔性印制电路板（FPC）的基板材料—挠性覆铜板（FCCL）用重要的绝缘基材，同时，也是PI膜深加工产品的前驱体材料。公司生产的高性能微电子级PI膜产品介电强度、热/吸湿膨胀系数、拉伸强度等指标达到或优于国际同类产品水平，可应用于挠性印制电路板领域、绝缘材料领域、半导体及微电子工业领域、非晶硅太阳能电池领域等。

### （二）主要经营模式及主要业绩驱动因素

公司主要经营模式为以销定产，直销和经销相结合。公司在深化与现有客户良好合作的基础上，积极拓展国内外市场，持续提升公司核心竞争力，同时继续沿着公司产业链延伸，拓宽PI膜应用领域。不断丰富产品结构、持续提升产品技术水平以响应市场变化与客户需求的的能力，是公司当前及未来重要的业绩驱动因素。

### （三）行业情况

柔性印制电路板需求由下游终端电子产品需求所主导。全球柔性印制电路板行业近年来保持较快发展，其中，智能手机、平板电脑、车载电子等移动电子设备为首的消费类电子产品更新换代，AR/VR/可穿戴智能设备、消费级无人机等电子产品兴起和发展，汽车电子化、无线充电以及柔性OLED显示屏等产品市场增长；5G趋近商用也助力了高频FPC的发展；同时，各类电子产品显示化、触控化的趋势也使得FPC借助中小尺寸液晶屏及触控屏进入广阔的应用空间。

微电子级PI膜主要应用于FCCL的制造及作为PI膜深加工产品的前驱体材料。微电子级PI膜及其深加工产品具有广阔的应用前景和巨大的商业价值，是微电子封装领域关键的配套材料，在微电子封装技术发展进程中具有决定性的作用和重要的基础地位、先行地位和制约地位。随着PI膜的技术发展，微电子级PI膜及其深加工产品的性能不断提升，其应用范围内也在不断扩大，如用于散热材料、光电显示材料、新能源材料等。目前PI膜及其深加工产品已经被广泛应用于消费电子、新型显示、新能源等多个领域，受益于下游行业的蓬勃发展，微电子级PI膜及其深加工产品的市场前景广阔。

公司成立以来，专注于柔性印制电路及新型功能性高分子材料的研发，在柔性印制电路板及电子级PI膜领域深耕近二十年。公司的行业地位突出，先后承担并完成了两项国家“863计划”重大研究课题、两项国家科技重大专项项目（02专项）和多项国家级、省市级科技攻关项目。公司在柔性印制电路板及PI膜领域具有深厚的技术积累，取得多项创新成果，获得四十余项国家发明专利和国际专利。公司坚持实施高端产品竞争战略，通过多年的技术创新和市场开拓，已经形成较为完整的产业链和合理的产品结构，是全球极少数掌握微电子级PI膜、高端2L-FCCL、COF柔性封装基板到COF芯片封装全产业链中各环节主要材料制造工艺并大批量生产的厂商之一。

## 3、主要会计数据和财务指标

### （1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

单位：元

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入	347,148,108.89	343,586,590.45	1.04%	317,158,467.26
归属于上市公司股东的净利润	17,335,035.40	25,415,213.78	-31.79%	25,373,613.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,977,915.49	17,187,687.53	-36.13%	100,400.82
经营活动产生的现金流量净额	155,676,523.06	213,484,373.76	-27.08%	212,631,765.38
基本每股收益（元/股）	0.03	0.05	-40.00%	0.05
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.05	-40.00%	0.05
加权平均净资产收益率	1.01%	1.40%	-0.39%	1.51%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末

资产总额	2,492,634,263.05	2,419,192,948.17	3.04%	2,590,785,519.58
归属于上市公司股东的净资产	1,735,360,272.32	1,715,897,669.55	1.13%	1,692,763,139.48

## (2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	72,082,159.73	97,166,068.29	105,730,526.85	72,169,354.02
归属于上市公司股东的净利润	2,425,146.20	10,954,522.84	10,076,354.71	-6,120,988.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	662,400.33	8,590,077.02	9,226,543.66	-7,501,105.52
经营活动产生的现金流量净额	-11,362,813.33	42,762,366.38	-6,628,945.31	130,905,915.32

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

## 4、股本及股东情况

### (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

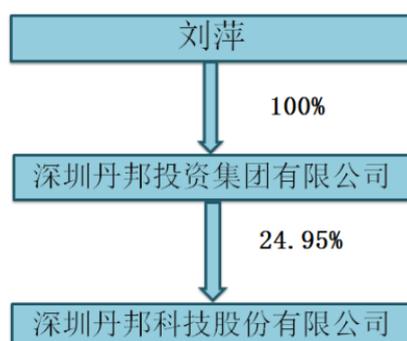
报告期末普通股股东总数	24,231	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	46,029	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
深圳丹邦投资集团有限公司	境内非国有法人	24.95%	136,699,600	0	质押	25,000,000	
深圳市丹依科技有限公司	境内非国有法人	6.18%	33,835,053	0	冻结	33,835,053	
陈颖	境内自然人	2.17%	11,897,300	0			
蒋亦飞	境内自然人	1.64%	8,994,600	0			
林培	境内自然人	1.59%	8,731,451	0			
汪涓	境内自然人	1.33%	7,299,900	0			
邱严杰	境内自然人	1.21%	6,645,759	0			
李正芳	境内自然人	1.13%	6,195,300	0			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.79%	4,347,683	0			
李继梅	境内自然人	0.70%	3,830,000	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、控股股东深圳丹邦投资集团有限公司法人代表刘萍与深圳市丹依科技有限公司主要股东刘文魁为叔侄关系；2、除此之外，未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前十大股东中，深圳丹邦投资集团有限公司通过信用证券账户持有 9,000,000 股；蒋亦飞通过信用证券账户持有 8,994,600 股；李正芳通过信用证券账户持有 6,091,100 股；李继梅通过信用证券账户持有 2,750,000 股。						

## (2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

## (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 三、经营情况讨论与分析

### 1、报告期经营情况简介

2019年，国内外宏观经济形势依旧复杂，政治经济形势的不确定给全球电子产业链的发展带来了一定的阻力。公司继续围绕做强主营业务以及推进产业链布局两大主线的发展战略进行经营管理，攻坚克难，敢于创新，积极为公司后续发展奠定坚实基础。报告期内，公司实现营业收入347,148,108.89元，同比上升了1.04%；营业利润16,422,642.00元，同比下降了36.61%；利润总额16,118,034.51元，同比下降了37.83%；归属于上市公司股东的净利润17,335,035.40元，同比下降了31.79%。截止至2019年12月底，公司总资产余额2,492,634,263.05元，比期初上升了3.04%，总负债余额757,273,990.73元，资产负债率30.38%；归属于上市公司股东的所有者权益余额1,735,360,272.32元，比期初增长了1.13%；归属于上市公司股东的每股净资产3.17元，同比增长了1.28%。

报告期主要工作回顾：

#### (一) 聚焦公司业务，积极推进新产品市场化

报告期内，公司持续强化主营传统业务柔性印制电路板的高端路线，提升技术含量高、应用领域相对高端的差异化产品的生产，进一步提高对客户的配套能力，提高与原有市场及客户的合作深度和广度，在原有客户基础上，追踪下游行业应用趋势，拓展行业中领先的其他客户，增强客户的多样性，提升市场占有率；公司的PI膜产品从逐步减少相应的PI膜原材料外部采购，到自产PI膜的自用基本上覆盖公司对PI膜原材料的需求。PI膜产品对外销售收入下降，主要因为公司积极布局新业务，扩大了PI厚膜及其深加工产品的研发工作，同时为了保障后续“TPI薄膜碳化技术改造项目”订单的PI厚膜材料的储备，公司扩大了PI厚膜的生产，减少了PI薄膜的生产；报告期末，“TPI薄膜碳化技术改造项目”的客户认证工作进入后期阶段，公司就产品认证进展与下游客户保持密切的沟通和接触，同时，提升项目产品工艺、稳定性及交付能力，为实现规模化生产、产品早日进入市场、合同的平稳履行提供有效保障。

#### (二) 积极布局新项目

PI厚膜及量子碳化合物厚膜。完成“化学法电子级特种聚酰亚胺厚膜（130μm/140μm/150μm/160μm/170μm）”及“量子碳化合物厚膜”的技术攻关，先后取得“柔性聚酰亚胺制备的碳膜及其制备方法”等核心技术的发明专利，掌握制备量子碳化合物厚膜的核心工艺与技术，实现自主知识产权技术，规模化生产具备技术可行性。

透明PI薄膜。在通用PI膜的基础上，公司继续开展PI膜功能化研究，丰富自产PI膜的规格及品种，重点研发方向之一即是高透明、高耐热性聚酰亚胺薄膜。开展“新型透明PI膜中试”项目研究，形成了与新型透明PI膜直接相关的专利“透明聚酰亚胺薄膜、其前驱体及其制备方法”，取得了阶段性成果，中试化生产具备技术可行性。

量子碳化合物半导体膜。公司切入化合物半导体材料领域，开展“量子碳化合物半导体膜研发”项目研究，拟研制耐高低

温、高压、高频性能、大宽幅、超柔韧、超薄层微结构的化合物半导体材料。公司已形成一定技术成果，取得了专利“PI膜制备多层石墨烯量子碳基二维半导体材料方法”，本项目具备实施所需的技术基础。

### （三）推进非公开发行股票项目

作为国内较早进入聚酰亚胺（PI）行业的公司，在长期技术积累的基础上，公司欲进一步拓展PI膜的应用领域，提高公司的整体竞争能力。2019年6月公司启动了非公开发行股票项目，鉴于《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规、规范性文件的修订及资本市场环境的变化，并综合考虑公司业务规划、PI膜相关研发进展等因素，公司终止了2019年非公开发行股票事项，推出2020年非公开发行方案，公司2020年第一次临时股东大会审议通过了此项议案。公司将积极推进落实本次非公开发行股票的各项相关工作。

### （四）治理创新，为企业赋能

报告期，公司围绕业务发展，以提高经营管理体制为主线，通过梳理产品研发、生产、销售各项管理流程、体系维护、指标管理，调整和优化运营环节，进一步规范管理流程，并多举措加强安全环保管理工作，深化公司内部环境治理，以满足公司战略发展需要。

持续研发创新，扩大产品应用领域，增强本公司系列产品的生命力和可持续发展性，满足市场多元化的需求。公司开展了新型高性能柔性电路板及基材的新工艺、新方法、新材料的研究，同时在实现常规厚度PI薄膜生产的基础上，加大对大宽幅PI厚膜（厚度110μm-170μm）、功能型PI膜以及非薄膜形态PI制品的研发。报告期内，公司申请/取得了8项发明专利，此外公司及全资子公司顺利通过国家高新技术企业重新认定。

## 2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是  否

## 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用  不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
FPC	76,025,424.30	45,016,245.70	40.79%	25.95%	22.36%	1.74%
COF 柔性封装基板	152,694,090.65	86,617,810.34	43.27%	-4.13%	-6.39%	1.36%
COF 产品	111,730,727.00	63,349,926.77	43.30%	5.12%	3.28%	1.01%

## 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是  否

## 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用  不适用

会计报表项目	本年	上年同期	增减变动	原因
净利润	17,335,035.40	25,415,213.78	-31.79%	主要系计提存货减值备增加所致。

## 6、面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 7、涉及财务报告的相关事项

### (1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

详见本报告“第十二节 财务报告”-“五、重要会计政策及会计估计”-30、重要会计政策和会计估计变更

### (2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

### (3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

深圳丹邦科技股份有限公司

董事长：刘萍

二〇二〇年六月二十九日